

文件类别:	TECH
文件标题:	铝箔封口垫片知识之二——感应层
文件版本:	Rev.01-0424
文件编号:	WMT-130516-01

## 铝箔封口垫片知识之二——感应层

### 感应层的作用

[铝箔垫片](#)在封口操作时需要受热，使热封层与容器口熔合并密封，电磁感应封口机虽然是加热的设备，但实际上真正产生热源的是铝箔垫片上的感应层。

铝箔垫片封口时以非接触的方式加热（即铝箔封口机在封口时不需与铝箔垫片有任何的接触），感应层之所以能发热，是因为在电磁感应铝箔封口机的交变磁场作用下，感应层产生涡流电流，在涡流电流的作用下，感应层发热，从而对铝箔垫片的封口层加热。

### 感应层的材质

[铝箔封口垫片](#)的感应层要在电磁感应铝箔封口机的交变电流下产生涡流电流，所以，感应层必须是一种导体。

在多种金属导体中，合金铝箔就是最理想的一种。因为合金铝箔其延展性好，方便加工，导电性良好，而且价格低廉，工业品市场和日用消费品市场中都已经批量生产，所以非常适合铝箔垫片感应层的工业大批量生产应用。

### 封口层铝箔的厚度

当封口层材质已经确定使用铝箔，那么，铝箔的厚度决定了铝箔垫片的生产成本和用户封口时的工作效率。

一般情况下10um 的铝箔在感应涡流电流的作用下已经可以将封口层加热至熔融状态，但由于其加热的时间会稍长，而且当感应封口机封口头与铝箔垫片的距离增加时感应会失效，所以感应层铝箔厚度一般在15um 以上。现在铝箔垫片感应层的厚度多为下面几种：15um，17um，20um，25um，30um 等。

封口层铝箔厚度的增加，会提升用户封口时操作的效率，但同时也将增加垫片材料成本。这方面需要用户根据自己的实际使用情况来权衡。

**\*\*版权声明\*\***

本文版权为慧铭包装所有，如需引用，请注明出处 [www.weymen.com](http://www.weymen.com)。如需更多的包装容器封口技术资料，请访问：  
<http://www.weymen.com/technology.html> 。